

证券简称：晶合集成

证券代码：688249

合肥晶合集成电路股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-015

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	天风电子、南方基金、华安证券、民生加银基金、申万宏源、兴业基金、山西证券、道翼资本。
会议时间	2023年12月6日-2023年12月7日
会议地点	公司会议室、线上会议
上市公司接待人员姓名	朱才伟 董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理 黄凯全 企业规划室部经理 曹宗野 证券事务代表
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1、目前 DDIC 终端去库存情况如何？</p> <p>答复：自今年二季度终端去库存化取得了一定的成效，目前库存情况恢复到相对比较健康的水位。</p> <p>问题 2、公司 2021-2022 年的毛利率较高的原因？</p> <p>答复：公司 2021-2022 年综合毛利大概在 45%左右，主要原因是当时市场需求旺盛，产品的单价持续上涨，并且产能一直处于满载状态。</p> <p>问题 3、公司的产品结构以及不同制程的收入分布情况？</p> <p>答复：以 2023 年 6 月为例，按应用产品分类看，DDIC、CIS、PMIC、MCU 占主营业务收入的比例分别</p>

	<p>为 87.84%、4.08%、5.77%、1.35%。按制程节点分类，55nm、90nm、110nm、150nm 占主营业务收入的比例分别为 4.83%、49.92%、31.65%、13.60%。</p> <p>目前公司产品结构正在持续优化、工艺平台正往多元化发展。</p> <p>问题 4、从制程节点看，目前哪个制程节点的产能利用率最高？</p> <p>答复：目前公司 55nm 的产能利用率比较饱满，该制程产品基本处于满载状态。55nm 制程产品的营收稳步提高。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 12 月 8 日